

## FFH S1/26H F1 B RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

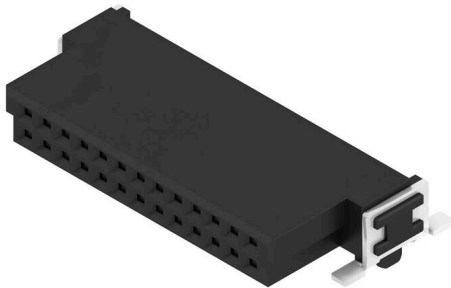
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Produktbild



OMNIMATE® - Board-to-Board-Steckverbinder  
Flexible Konstruktion von Kompaktgeräten  
Der Einsatz zukunftssicherer Kontaktsysteme sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen werden bei der Entwicklung effizienter Industriegeräte, insbesondere in der Industry 4.0, immer wichtiger. OMNIMATE® Board-to-Board-Steckverbinder besitzen ein 1,27-mm-Raster und bieten dank unterschiedlicher Ausführungen maximale Flexibilität.

- Flexible Gerätekonstruktion - Industrietaugliche Packungsdichte gepaart mit hochflexiblen Verbindungskombinationen (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Erweiterungskarte, Cable-to-Board)
- Automation-Ready - Entwickelt für die Automatenbestückung mit hochpräziser Kontakt-Koplanarität und SMT-Fixierung
- Zuverlässiger Kontakt - Bis zu 500 Steckzyklen durch industrietaugliche Goldoberfläche (PdNi-Au)
- Process-Ready - Hochleistungsfähiges LCP-Material für Reflow-Löten
- Skalierbarkeit - Unterschiedliche Höhen mit hoher Kontaktüberlappung gewährleisten unterschiedliche Lösungen mit 12–80 Polen.
- Robuste Miniaturisierung - einfache und sichere Verbindung auch bei ungünstigen Steckbedingungen – z. B. Schrägstellung oder Versatz.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 26, 90°, Tape
Best.-Nr.	<a href="#">2747460000</a>
Art	FFH S1/26H F1 B RL
GTIN (EAN)	4064675000877
VPE	560 ST
Produkt-Kennzahlen	IEC: / 2.8 A UL: 150 V
Verpackung	Tape

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cURus)	E92202

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10.9 mm	Tiefe (inch)	0.4291 inch
Höhe	3.7 mm	Höhe (inch)	0.1457 inch
Breite	21.59 mm	Breite (inch)	0.85 inch
Nettogewicht	3.88 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Systemkennwerte

Übertragungsrate	3,125 Gbit/s	Produktfamilie	OMNIMATE Signal - Board-to-Board
Anschlussart	Platinenanschluss	Montage auf der Leiterplatte	SMD-Lötanschluss
Raster in mm (P)	1.27 mm	Raster in Zoll (P)	0.050 "
Abgangswinkel	90°	Polzahl	26
Anzahl Lötstifte pro Pol	1	Koplanarität	0.1 mm
Anzahl Reihen	1	Polreihenanzahl	2
Schutzart	IP20	Durchgangswiderstand	<25 mΩ
Steckzyklen	500	Steckkraft/Pol, max.	0.6 N
Ziehkraft/Pol, max.	0.6 N		

### Werkstoffdaten

Isolierstoff	LCP	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolierstoffgruppe	Illa
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>10</sup> Ω	Moisture Level (MSL)	1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Kontaktbasismaterial	Kupferlegierung
Kontaktmaterial	Cu-leg	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Schichtaufbau - Steckkontakt	≥ 2 µm Ni / ≥ 0.4 µm PdNi / ≥ 0.05 µm Au	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-55 °C
Betriebstemperatur, max.	125 °C		

### Bemessungsdaten nach IEC

Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)	2.8 A	Kriechstrecke, min.	0.4 mm
Luftstrecke, min.	0.4 mm		

### Nennwerten nach UL 1977

Hinweis zu den Zulassungswerten	Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.	Bemessungsspannung (UL 1977) (veraltet)	150 V
---------------------------------	---	---	-------

**Technische Daten****Verpackungen**

Verpackung	Tape	VPE Länge	350.00 mm
VPE Breite	340.00 mm	VPE Höhe	135.00 mm

**Wichtiger Hinweis**

IPC-Konformität	Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
-----------------	--

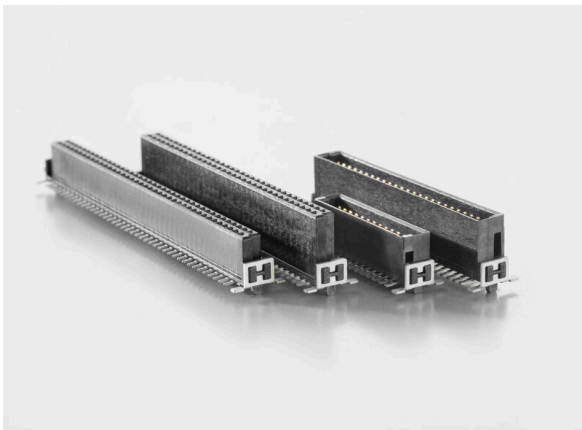
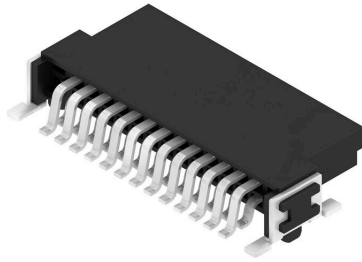
Hinweise

**Klassifikationen**

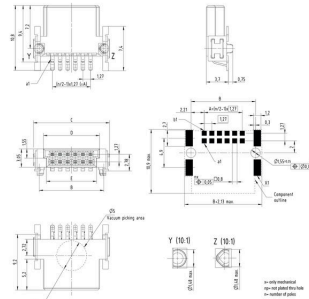
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

# Zeichnungen

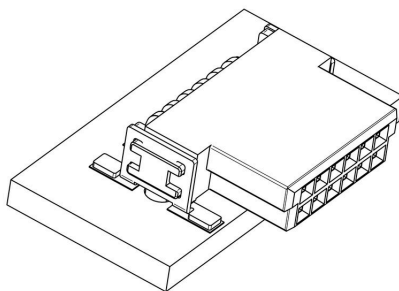
## Produktbild



Type	Order no.	No. of poles	A	B	C	D	E
FFH S1/26H F1 B RL	2747430000	12	6.35	19.27	12.7	5.37	8.37
FFH S1/26H F1 B RL	2747430001	16	6.35	19.27	15.24	11.81	10.81
FFH S1/26H F1 B RL	2747430002	20	11.43	15.88	17.19	14.45	13.45
FFH S1/26H F1 B RL	2747430003	26	15.48	15.88	21.49	18.29	17.29
FFH S1/26H F1 B RL	2747430004	32	18.68	22.47	26.4	22.57	21.57
FFH S1/26H F1 B RL	2747430005	40	24.43	26.81	30.48	27.15	26.15
FFH S1/26H F1 B RL	2747430006	50	31.43	34.3	38.63	33.1	32.1
FFH S1/26H F1 B RL	2747430007	60	41.87	40.27	46.29	44.93	43.93
FFH S1/26H F1 B RL	2747430008	80	48.53	53.91	58.68	52.55	51.55



## Detailzeichnung



## Deratingkurve



**Zeichnungen**



### FMH – Stiftleiste, Leiterplattenanschluss



#### OMNIMATE® - Board-to-Board-Steckverbinder

Flexible Konstruktion von Kompaktgeräten

Der Einsatz zukunftssicherer Kontaktsysteme sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen werden bei der Entwicklung effizienter Industriegeräte, insbesondere in der Industry 4.0, immer wichtiger. OMNIMATE® Board-to-Board-Steckverbinder besitzen ein 1,27-mm-Raster und bieten dank unterschiedlicher Ausführungen maximale Flexibilität.

- Flexible Gerätekonstruktion - Industrietaugliche Packungsdichte gepaart mit hochflexiblen Verbindungskombinationen (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Erweiterungskarte, Cable-to-Board)
- Automation-Ready - Entwickelt für die Automatenbestückung mit hochpräziser Kontaktkoplanarität und SMT-Fixierung
- Zuverlässiger Kontakt - Bis zu 500 Steckzyklen durch industrietaugliche Goldoberfläche (PdNi-Au)
- Process-Ready - Hochleistungsfähiges LCP-Material für Reflow-Löten
- Skalierbarkeit - Unterschiedliche Höhen mit hoher Kontaktüberlappung gewährleisten unterschiedliche Lösungen mit 12–80 Polen.
- Robuste Miniaturisierung - einfache und sichere Verbindung auch bei ungünstigen Steckbedingungen – z. B. Schrägstellung oder Versatz.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	FMH S1/26H F1 B RL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2747190000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in
GTIN (EAN)	4064675000976	mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 26, 90°, Tape
VPE	560 ST	

### FMH1 – Stiftleiste, Leiterplattenanschluss (Bauhöhe 1,75 mm)



#### OMNIMATE® - Board-to-Board-Steckverbinder

Flexible Konstruktion von Kompaktgeräten

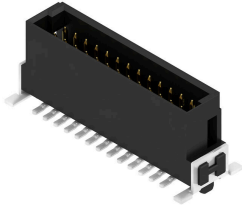
Der Einsatz zukunftssicherer Kontaktsysteme sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen werden bei der Entwicklung effizienter Industriegeräte, insbesondere in der Industry 4.0, immer wichtiger. OMNIMATE® Board-to-Board-Steckverbinder besitzen ein 1,27-mm-Raster und bieten dank unterschiedlicher Ausführungen maximale Flexibilität.

- Flexible Gerätekonstruktion - Industrietaugliche Packungsdichte gepaart mit hochflexiblen Verbindungskombinationen (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Erweiterungskarte, Cable-to-Board)
- Automation-Ready - Entwickelt für die Automatenbestückung mit hochpräziser Kontaktkoplanarität und SMT-Fixierung
- Zuverlässiger Kontakt - Bis zu 500 Steckzyklen durch industrietaugliche Goldoberfläche (PdNi-Au)
- Process-Ready - Hochleistungsfähiges LCP-Material für Reflow-Löten
- Skalierbarkeit - Unterschiedliche Höhen mit hoher Kontaktüberlappung gewährleisten unterschiedliche Lösungen mit 12–80 Polen.
- Robuste Miniaturisierung - einfache und sichere Verbindung auch bei ungünstigen Steckbedingungen – z. B. Schrägstellung oder Versatz.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	FMH1 S1/26V F1 B RL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2747010000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in
GTIN (EAN)	4064675001225	mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 26, 180°, Tape
VPE	280 ST	

### FMH3 – Stiftleiste, Leiterplattenanschluss (Bauhöhe 3,25 mm)



#### OMNIMATE® - Board-to-Board-Steckverbinder

Flexible Konstruktion von Kompaktgeräten

Der Einsatz zukunftssicherer Kontaktsysteme sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen werden bei der Entwicklung effizienter Industriegeräte, insbesondere in der Industry 4.0, immer wichtiger. OMNIMATE® Board-to-Board-Steckverbinder besitzen ein 1,27-mm-Raster und bieten dank unterschiedlicher Ausführungen maximale Flexibilität.

- Flexible Gerätekonstruktion - Industrietaugliche Packungsdichte gepaart mit hochflexiblen Verbindungskombinationen (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Erweiterungskarte, Cable-to-Board)
- Automation-Ready - Entwickelt für die Automatenbestückung mit hochpräziser Kontaktkoplanarität und SMT-Fixierung
- Zuverlässiger Kontakt - Bis zu 500 Steckzyklen durch industrietaugliche Goldoberfläche (PdNi-Au)
- Process-Ready - Hochleistungsfähiges LCP-Material für Reflow-Löten
- Skalierbarkeit - Unterschiedliche Höhen mit hoher Kontaktüberlappung gewährleisten unterschiedliche Lösungen mit 12–80 Polen.
- Robuste Miniaturisierung - einfache und sichere Verbindung auch bei ungünstigen Steckbedingungen – z. B. Schrägstellung oder Versatz.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	FMH3 S1/26V F1 B RL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2747100000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in
GTIN (EAN)	4064675001218	mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 26, 180°, Tape
VPE	280 ST	